

日月光一〇四年度第二季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 104 年 7 月 30 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇四年度第二季獲利報告，本公司一〇四年第二季之合併營業收入較一〇四年第一季成長 9%，較一〇三年同期成長 20%，為新台幣 70,222 百萬元。茲將日月光一〇四年度第二季單季及上半年之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

合併綜合損益表（單位：新台幣百萬元）

項 目	104 年度 第二季	104 年度 第一季	103 年度 第二季	104 年度 上半年	103 年度 上半年
營業收入淨額	70,222	64,662	58,615	134,884	113,315
營業毛利	11,566	12,313	12,610	23,879	22,970
營業淨利（淨損）	5,409	6,292	6,615	11,701	11,700
稅前淨利（淨損）	5,400	5,506	6,065	10,906	10,364
所得稅利益（費用）	(1,596)	(856)	(821)	(2,452)	(1,551)
非控制權益	(152)	(181)	(138)	(333)	(257)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	3,652	4,469	5,106	8,121	8,556
基本每股盈餘(新台幣元)	0.48	0.58	0.66	1.06	1.12
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.43	0.56	0.65	1.02	1.08

綜合損益表 - 半導體封裝測試（單位：新台幣百萬元）

項 目	104 年度 第二季	104 年度 第一季	103 年度 第二季	104 年度 上半年	103 年度 上半年
營業收入淨額	37,671	38,605	39,266	76,276	73,617
營業毛利	9,504	9,995	10,599	19,499	18,852
營業淨利（淨損）	5,101	5,546	5,986	10,647	10,208
稅前淨利（淨損）	5,229	5,230	5,794	10,459	9,847
所得稅利益（費用）	(1,537)	(709)	(650)	(2,246)	(1,223)
非控制權益	(40)	(52)	(38)	(92)	(68)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	3,652	4,469	5,106	8,121	8,556

半導體封裝測試銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	55
電腦	10
汽車, 消費性電子及其它	35
前十大客戶佔營收比重	51

銷售地區別佔比	%
北美	62
歐洲	12
台灣	16
日本	5
亞洲其它地區	5

封裝業務產品組合	%
Advanced Packaging	31
IC Wirebonding	57
Discrete and Others	12
封裝資本支出金額	140 百萬美元
打線機台數	15,662 台

測試業務產品組合	%
後段測試	75
晶圓測試	21
前段測試	4
測試資本支出金額	43 百萬美元
測試機台數	3,370 台

電子代工服務銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	44
電腦	13
消費性電子	28
工業用	9
汽車電子	5
其它	1
前十大客戶佔營收比重	92
EMS 資本支出金額	27 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2015 年第三季的業績展望如下：

- 半導體封測事業之產能應持平，產能利用率應成長 1% 至 5%；
- 半導體封測事業之毛利率應與第一季水準相近；
- 電子代工服務生意量應接近 4Q14 水準；
- 電子代工服務毛利率應小幅下滑。